

NOTES:

1) MATERIAL:

HOUSING & INSULATOR: NYLON(PA), GLASS FILLED, UL94V-0, COLOR: BLACK
TERMINALS: PHOSPHOR BRONZE, .012/(0.30) THICK
SHIELD: BRASS

2) FINISH:

TERMINALS:

- A = SELECT GOLD IN CONTACT AREA: .000050/(0.00127) MIN.,
*SELECT MATTE TIN IN PC TAIL AREA: .000100/(0.00254) MIN.,
WITH OVERALL NICKEL UNDERPLATE: .000050/(0.00127) MIN.
B = SELECT GOLD IN CONTACT AREA: .000030/(0.00076) MIN.,
*SELECT MATTE TIN IN PC TAIL AREA: .000100/(0.00254) MIN.,
WITH OVERALL NICKEL UNDERPLATE: .000050/(0.00127) MIN.
C = SELECT GOLD IN CONTACT AREA: .000015/(0.00038) MIN.,
*SELECT MATTE TIN IN PC TAIL AREA: .000100/(0.00254) MIN.,
WITH OVERALL NICKEL UNDERPLATE: .000050/(0.00127) MIN.

SHIELD:

- *100 MICROINCHES NICKEL OVER 50 MICROINCHES COPPER UNDERPLATE
PCB GROUND TABS DIPPED IN TIN
*THE PRIMARY SHIPPING CARTON WILL BE LABELED "COMPLIANT TO RoHS
DIRECTIVE 2002/95/EC AND ELV ANNEX II OF DIRECTIVE 2000/53/EC".
CARTONS WITHOUT THIS LABEL MAY CONTAIN PRODUCT WITH TIN-LEAD
IN THE PC TAILS AND/OR SHIELD.

3) PRODUCT SPECIFICATION AND PROCESSING PARAMETERS: PS-43743-0001.

4) PACKAGING SPECIFICATION:

CONNECTOR ASSEMBLIES TO BE PACKAGED USING TAPE & REEL SYSTEM
PER PACKAGING DRAWING PK-70873-7006.

5) COPLANARITY SPECIFICATION:

WHEN AN ASSEMBLY IS PLACED UPON A LEVEL SURFACE, THE MAXIMUM
GAP BETWEEN THE LEVEL SURFACE AND ALL TERMINAL TAILS AND
FRONT SOLDER TAB IS .006/(0.15).

6) THRU HOLES .094±.002/(2.39±0.05) ARE FOR SHIELDS WITH LOCATION TABS ONLY.

7) AVAILABLE WITH (4) OPTIONAL SIDE GROUND TABS (OMITTED FOR SIDE TO SIDE
STACKABILITY).

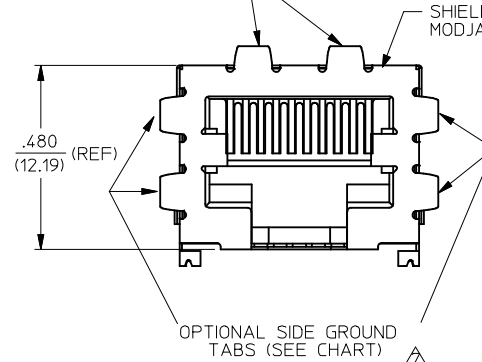
8) AVAILABLE WITH (2) OPTIONAL LOCATION TABS FOR LOCATING COMPONENT
TO PCB AND/OR GROUNDING TO PCB.

9) FOR ASSEMBLIES HAVING VOIDED CIRCUITS, THE TAIL PORTION IS CUT
AND REMOVED. THE MATING PORTION OF THE TERMINAL REMAINS INTACT.

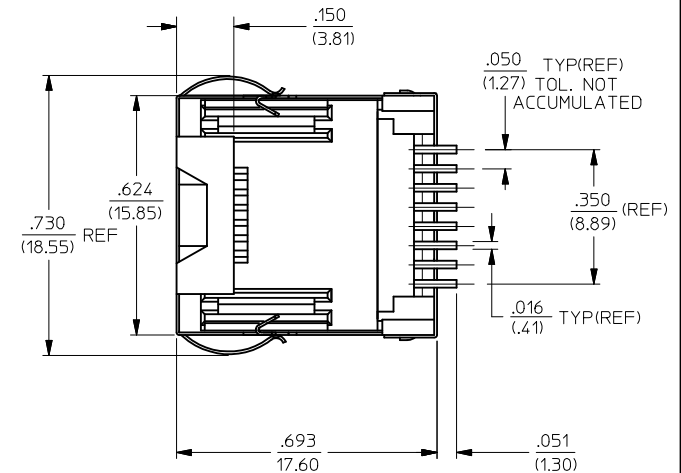
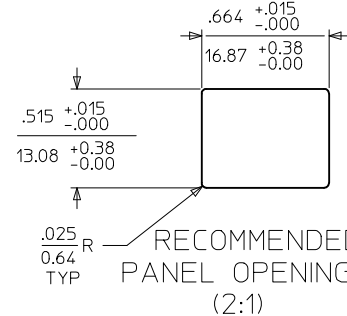
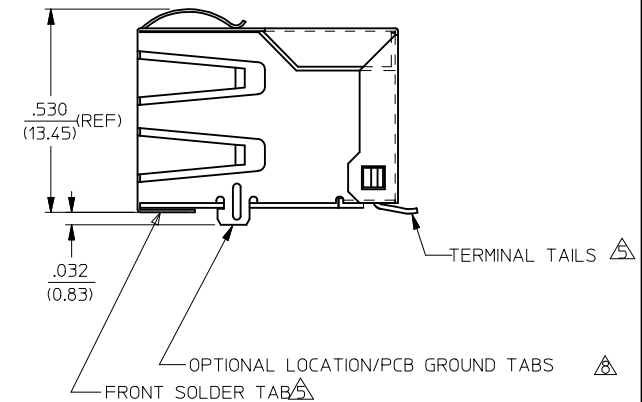
10) CONFORMS TO FCC REGULATION PART 68.5 FOR MODULAR JACKS.

11) THIS PART CONFORMS TO CLASS B REQUIREMENTS OF COSMETIC
SPECIFICATION PS-45499-002.

OPTIONAL TOP GROUND TABS
(SEE CHART)



SHIELDED SMT
MODJACK ASSEMBLY



44282-1004	A	NO	NO	YES	NONE
44282-0012	C	NO	YES	NO	NONE
44282-0011	B	NO	YES	NO	NONE
44282-0010	A	NO	YES	NO	NONE
44282-0009	C	YES	YES	NO	NONE
44282-0008	B	YES	YES	NO	NONE
44282-0007	A	YES	YES	NO	NONE
44282-0006	C	NO	YES	YES	NONE
44282-0005	B	NO	YES	YES	NONE
44282-0004	A	NO	YES	YES	NONE
44282-0003	C	YES	YES	YES	NONE
44282-0002	B	YES	YES	YES	NONE
44282-0001	A	YES	YES	YES	NONE

ASSEMBLY MAT. NO.	TERMINAL PLATING	SHIELD SIDE TABS	SHIELD TOP TABS	LOCATION TABS	VOIDED CIRCUITS
----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	------------------	--------------------

44282-0001, 44282-0002
& 44282-0003 SHOWN

REVISED NOTES EC NO: UCP2009-1244 DRWN: JKLOSTNER 2008/12/10 CHKD: JBELL 2008/12/10 APPR: FSMITH 2008/12/10 D3	DESCRIPTION ▽=0 ▽=0 REV	QUALITY SYMBOLS	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE		SCALE	DESIGN UNITS	THIRD ANGLE PROJECTION	TITLE SINGLE PORT, SHIELDED SIZE 8, 8 CIRCUIT SMT MODJACK
					IN/MM		1:1	INCH		
					DRAWN BY	DATE				
					CHECKED BY	DATE				
					APPROVED BY	DATE				

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

J

I

H

G

F

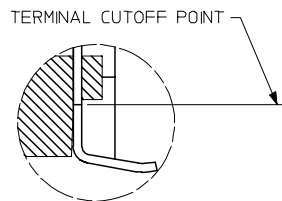
E

D

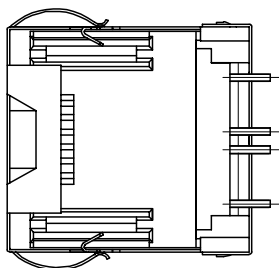
C

B

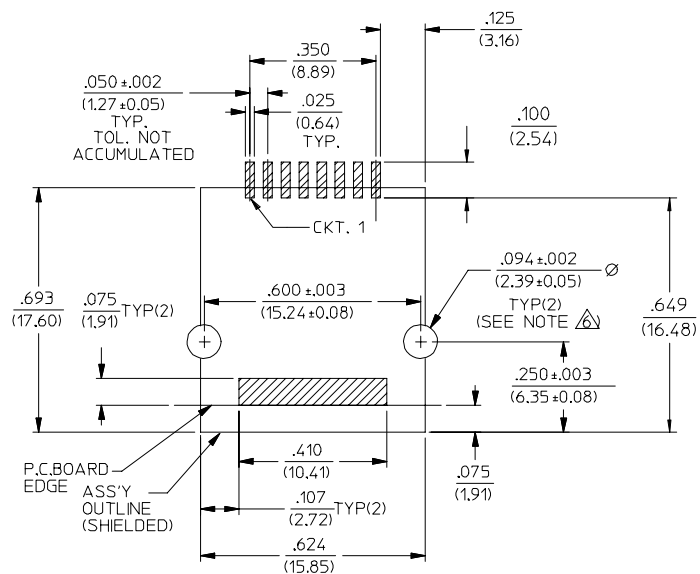
A



VIEW SHOWING TYPICAL TERMINAL
CUTOFF OF TAIL (SEE NOTE 10) FOR VOIDED CIRCUITS.



TYPICAL VIEW SHOWING VOIDED CIRCUIT
(CIRCUITS 2,3,6 & 7 SHOWN VOIDED)



PC BOARD LAYOUT FOR
8 POSITION HOUSING
(COMPONENT SIDE OF BOARD)

NOTES:
1. RECOMMENDED MINIMUM PCB THICKNESS: .034/0.86

SEE SHEET ONE EC NO: UCP2008-0143 DRAWN: J.BELL 2007/07/24 CHKD: L.S.H.M.I.D.T. 2007/07/30 APPR: F.S.M.T.H. 2007/08/01 D2	DESCRIPTION ▽=0 ▽=0	QUALITY SYMBOLS	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE IN/MM		SCALE 4:1	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION	SURFACE MOUNT MODULAR JACK W/ SHIELD
			mm	INCH	DRAWN BY STAMBAUG	DATE 99/06/03	TITLE			
			4 PLACES ± ---	± ---	CHECKED BY WIRKUS	DATE 99/06/03				
			3 PLACES ± ---	± .010	APPROVED BY EDGLEY		DATE 99/06/03	molex MOLEX INCORPORATED		
			2 PLACES ± 0.25	± ---	MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.			
			1 PLACE ± ---	± ---	SIZE C		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
			ANGULAR ±1/2°		SEE CHART		SD-44282-001			

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	
--	--

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.